



# 江苏辰达行电子有限公司

MICDIODE ELECTRONICS(JIANGSU) CO.,LTD

## 物质（铅）使用告知书

各相关方及合作伙伴：

敝司产品在 GPP 芯片制造中使用了含铅玻璃、封装制程中使用了含铅高温焊料，上述铅物质的使用均暂时无法替代，物质的使用适用于 RoHS Annex III 最新豁免条款：7(C)-I 和 7(a)；

敝司产品中铅的使用在 REACH（欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》的简称）第十九批公布的高关注物质有列出，且其检测铅含量大于 0.1%（约 2.2-2.5%），根据 REACH 法规的规定，特此向敝司相关方及合作伙伴予以告知，告知如下：

1. 敝司产品的 **MSDS** 或《物质成分表》将详细列出铅的使用材料对象和其含量，如需要可联系敝司之业务部门索取。
2. 敝司每年直接出口至欧盟的产品（指器件本体）中的铅总量远低于1吨1年（按照含量，折合成品的重量需要超过40吨，目前及未来也很难企及），未达到 REACH 注册申报的用量的要求。
3. 敝司产品客户端使用在客户的整机中而出口欧盟，因器件在整机中质量占比很小，故其铅物质在整机中的占比远远低于 0.1%（<REACH的注册申报的条件要求）。
4. 敝司产品中“铅”物质的使用，敝司向相关方和合作伙伴予以通报告知，彰显敝司产品不违反 REACH 的指令且不需申报注册。

注：根据 REACH 法规的要求，SVHC 中的任何一种物质：

1. 作为物质销售时，需要向下游用户提供 MSDS（安全数据表）。
2. 作为混合物（配制品）中的一种物质，当此物质含量度 $\geq 0.1\%$ 时，需要向下游用户提供 MSDS。
3. 在物品中 SVHC 质量百分比 $> 0.1\%$ 时，总量大于1吨/年的 SVHC，必须完成向 ECHA 通报的义务。

